

贴片及焊接工艺要求

产品型号	PCB 板型号	文件修改日期	页数
PARROT_H	PARROT_H_CON_V8 PARROT_H_POW_V8	2019.08.30	1

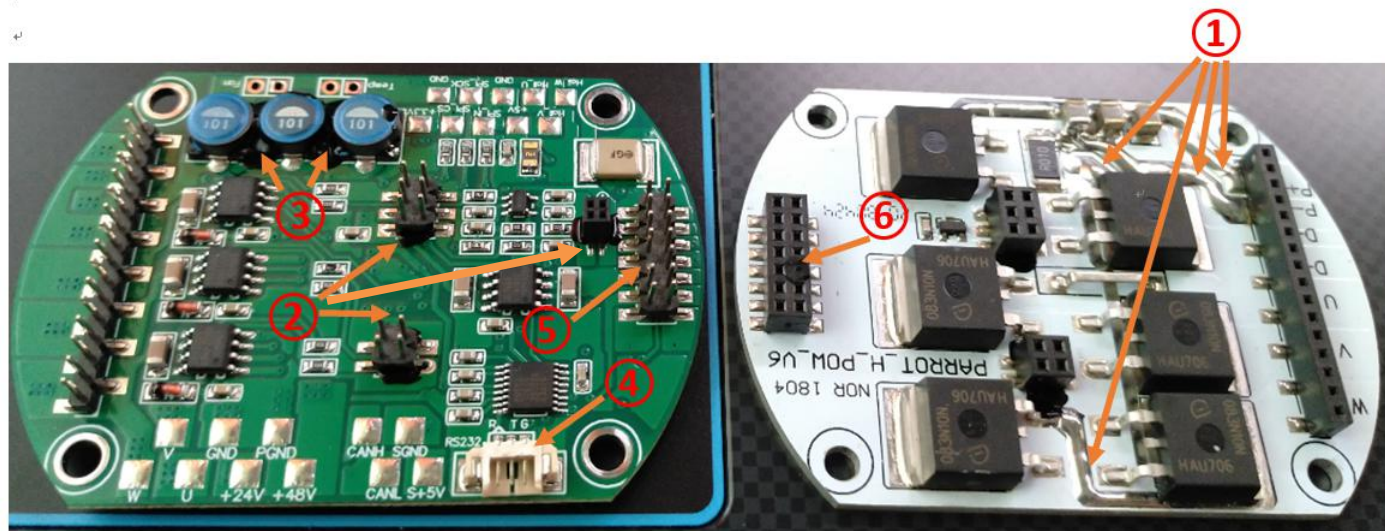
材料准备:

2.54_40P 直针、 704 黑色胶

要求:

1. 所有元器件均紧贴线路板焊接
2. 不焊接的元件: D3, R2; (U5 是要焊接的)
3. 所有插头插座要对齐中心位置, 偏差要小于 0.3mm, 否则影响上下板插接
4. 铝基板的功率管管脚要居中, 管脚不允许超出焊盘

以下为特殊操作部分



1. 铝基板有四根线是需要额外加锡的, 直接刷锡膏完成 (焊锡的高度不少于 0.5mm), 焊接时要注意;
2. 控制板和铝基板的内部插头、插座 (根部) 要两边点胶, 不能点到焊盘上, 背面的插头也同样处理;
3. 三个电感中间要点胶 (不要过多, 不能高出电感本身)
4. 不做处理 (忽略此项);
5. 剪掉控制板双排直针的第三根针 (从下方内侧数第三根);
6. 使用 2.54_40P 单排直针 (0.8*0.8 方针), 剪断 成 3mm, 放入铝基板双排 2*7 插座 (从下方板子内侧 数 第三个孔), 插针不能高出插件的平面;
7. 铝基板上面的 MOS 管引出脚要正对焊盘, 贴装时要注意, 否则容易造成管脚与旁边的焊盘相连;
8. 使用 2.54_40P 单排直针 (0.8*0.8 方针), 剪断 成 3mm, 放入控制板 JP3 的第 12 脚, 插针不能高出插件的平面;

注: 步骤 5 和 6 是为了防止插针错位, 两个操作的对应的。